

索尼半導體

公司分析報告

Sony Semiconductor Solutions

報告日期：2026年2月11日

代碼：6758.T (東京)

市值：~\$25B

目錄

一、公司概況	2
二、核心產品線	3
三、財務分析	4
四、市場競爭格局	5
五、風險評估	6
六、投資價值	7
七、附錄	8

1.1 基本信息

公司全稱	索尼半導體解決方案
英文名稱	Sony Semiconductor Solutions
總部	日本東京
上市地點	東京證券交易所
成立時間	2016年（從索尼分拆）
市值	約\$25B
員工規模	約9,000人

1.2 發展歷程

- 2016年：從索尼分拆，成立獨立公司
- 2020年：推出全球首款1億像素CIS
- 2021年：發布堆疊式CIS技術
- 2022年：車規級CIS突破
- 2023年：AI傳感器發布
- 2024年：車載CIS營收大增

1.3 業務架構

2.1 核心產品

CMOS圖像傳感器	全球第一，1億像素以上
ToF傳感器	3D感測技術領先
車規級CIS	自動駕駛攝像頭
Micro LED	AR/VR微顯示

2.2 終端應用



2.3 技術優勢

- 圖像傳感器第一：全球CMOS傳感器市占率~50%
- 堆疊式技術：堆疊式CIS技術領先
- AI傳感器：內置AI的傳感器
- 車規級認證：完整的車規級產品線

3.1 關鍵財務指標

FY2024營收 ~¥1.8T YoY +10%	毛利率 ~40%	營業利潤率 ~18%	車載CIS營收 ~\$1B
--------------------------------	-------------	---------------	------------------

3.2 季度趨勢

Q4 2024	營收¥500B，智能手機和汽車需求強勁
Q3 2024	營收¥480B，智能手機市場回暖
Q2 2024	營收¥450B，汽車CIS放量
Q1 2024	營收¥420B，價格穩定

3.3 業務構成

圖像傳感器	約75%營收
微型顯示	約10%營收
射頻芯片	約10%營收
其他	約5%營收

4.1 全球地位

全球CMOS傳感器	第1位（市占率~50%）
全球車載CIS	第1-2位
全球ToF傳感器	第1位
日本半導體	第5-6位

4.2 主要競爭對手

韋爾股份	中國CMOS傳感器龍頭
三星電子	CMOS傳感器競爭者
豪威科技	美國CMOS傳感器競爭者
意法半導體	ToF傳感器競爭者

4.3 競爭優勢

 CIS龍頭 全球CMOS傳感器第一	 技術領先 堆疊式CIS技術領先
---	---

<div><div></div><div>● 中風險</div><div>智能手機周期</div></div>	<div><div></div><div>● 中風險</div><div>韋爾競爭</div></div>	<div><div></div><div>● 低風險</div><div>技術落後</div></div>
<div><div></div><div>● 低風險</div><div>人才流失</div></div>	<div><div></div><div>● 中風險</div><div>價格壓力</div></div>	<div><div></div><div>● 低風險</div><div>匯率風險</div></div>

5.2 關鍵風險分析

- 智能手機周期：智能手機出貨量波動影響
- 韋爾競爭：中國韋爾股份快速追趕
- 價格壓力：CIS市場價格競爭加劇
- 汽車周期：自動駕駛普及進度

5.3 應對措施

- 加速車載CIS擴張
- 拓展安防和工業市場
- 加強AI傳感器研發
- 優化成本結構

7.1 主要客戶

智能手機	蘋果、三星、華為、小米
汽車	豐田、本田、特斯拉、比亞迪
安防監控	海康威視、大華股份
工業	西門子、博世

7.2 生產基地

日本	熊本（長崎）、山形
中國	無錫（索尼在半導體製造基地）
泰國	封裝測試

7.3 數據來源

- 公司年報 (2024)
- 東京證券交易所公告
- 行業研究報告 (Omdia, Yole)
- 索尼集團官方數據

6.4 催化劑